Low Contact Wafer Transfers

High Performance Wafer Handling Products

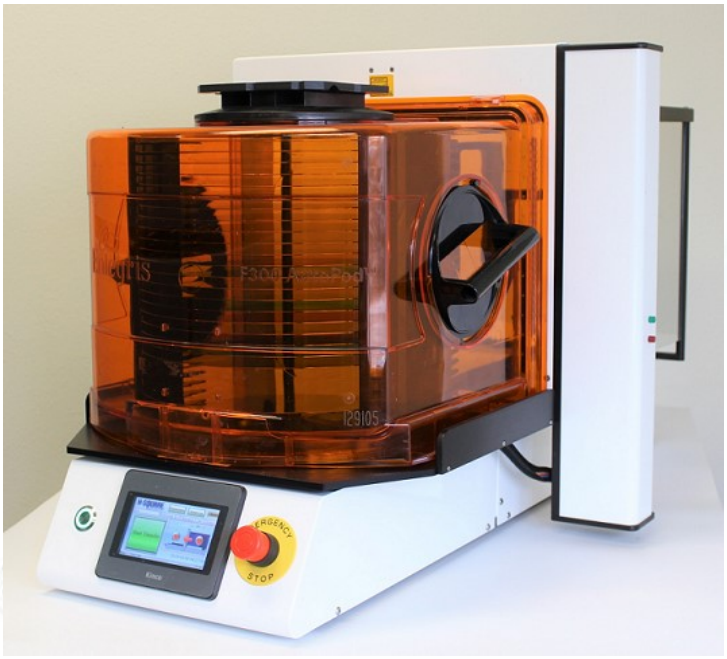
自動ウエハ水平移載装置

省スペース、高性能なローコンタクト水平移載機は
キャリア間でウエハを安全に一括移載する装置です。
プロセスキャリアからウエハを抜取り一旦保持し、
別キャリアに移し替えをします。
光及び機械センサーでエラーを監視します。
300mm 用はマッピング機能付きです。

76mm、100mm、150mm、200mm 用
型式：LCT2

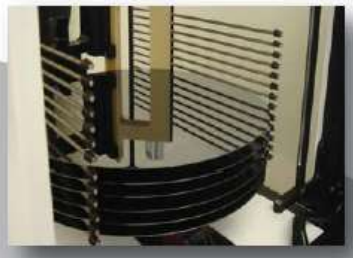
薄ウエハ、脆弱な基板(GaAs) 対応

バイピッチ、極薄ウエハ(300μ以下)用など
カスタム品の製作も承ります



300mm 用
型式：LCT1AS12

FOUP、FOSB、メタルカセット対応



ウエハ接触部：PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
耐摩耗性、耐薬品性に優れます

H-SQUARE CORPORATION
2991 Copper Road
Santa Clara, CA 95051 USA
T (408) 732-1240
F (408) 732-7970

ナガセテクノエンジニアリング株式会社
◇横浜市港北区新羽町 887 TEL 045-541-0208 FAX 045-541-0237
◇大阪市淀川区三津屋南 1-1-33 TEL 06-6838-8824 FAX 06-6828-8828